

2018-2024年中国高性能集成电路产业深度调研与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2018-2024年中国高性能集成电路产业深度调研与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/7741286EJP.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第一章高性能集成电路的行业界定8

第一节高性能集成电路的定义8

第二节高性能集成电路的行业发展历程8

第三节高性能集成电路的分类8

第四节高性能集成电路的特性9

第五节高性能集成电路发展的重要意义10

第二章2013-2016年中国高性能集成电路行业发展环境分析11

第一节2013-2016年中国经济环境分析11

一、宏观经济11

二、工业形势17

三、消费价格指数分析21

四、城乡居民收入分析22

五、全社会固定资产投资和工业投资分析23

六、进出口总额及增长率分析24

第二节2013-2016年中国高性能集成电路的行业发展政策环境分析25

一、行业发展相关政策25

颁布时间25

二、行业政策影响分析25

三、相关行业标准分析29

第三节2013-2016年中国高性能集成电路的行业发展技术环境分析29

一、技术发展概况29

二、技术发展趋势分析32

第四节十三五规划相关解读33

第三章2013-2016年中国高性能集成电路发展现状分析35

第一节我国高性能集成电路行业发展现状35

一、国际技术和市场形势分析35

二、中国本土企业的借鉴经验37

三、高性能集成电路产业继续突围发展的基本要领39

第二节高性能集成电路业：发展模式转型内需拉动回升40

一、扩内需使行业企稳回升41

二、产业链上下游重组初现41

三、高投入和高产出42

四、国际化发展模式42

五、周期性运行42

第三节中国高性能集成电路行业发展趋势分析42

一、未来中国高性能集成电路设计产业发展方向42

二、高性能集成电路封装技术的发展趋势43

第四章2013-2016年中国高性能集成电路行业发展分析45

第一节2013-2016年中国高性能集成电路的行业发展态势分析45

第二节2013-2016年中国高性能集成电路的行业发展特点分析46

第三节2013-2016年中国集成电路市场市场规模达7349.5亿元47

第四节2013-2016年中国高性能集成电路的行业市场供需分析48

一、我国高性能集成电路行业的快速发展与市场供给不足的矛盾依然持续49

二、未来需求增长国内集成电路加大产能49

三、供需趋势预测分析50

第五章我国高性能集成电路行业国家发展规划及产业政策51

第一节高性能集成电路产业发展规划51

一、产业规划的目标51

二、《规划》实施的重点内容51

三、《规划》面临的形势52

第二节国家资源综合利用产业政策分析53

第三节国家对高性能集成电路产业的政策53

一、国发〔2000〕18号文53

二、国发〔2011〕4号文54

三、国发[2011]4号与国发[2000]18号、财税[2008]1号文的对比性解读56

第四节我国规划将实施的高性能集成电路措施及政策59

一、落实扩大内需措施59

- 二、加大国家投入60
- 三、加强策扶持60
- 四、完善投融资环境60
- 五、支持优势企业并购重组60
- 六、进一步开拓国际市场60
- 七、强化自主创新能力建设61

第六章高性能集成电路行业技术分析62

第一节中国高性能集成电路行业技术发展现状62

- 一、高性能集成电路工艺发展现状62
- 二、高性能集成电路技术现状
- 三、高性能集成电路行业技术的更新
- 四、技术水平快速提高，技术与产品创新取得显著成果67

第二节中国高性能集成电路最新技术动态67

- 一、我国集成电路攻关喜获成绩67
- 二、我集成电路装备研发获重大突破68
- 三、集成电路多项核心技术获突破销售逾百亿69
- 四、集成电路装备专项带动相关产业增长近千亿元69
- 五、中国集成电路制造水平首次达到国际先进水平70
- 六、我国集成电路企业努力抢占封测技术高地70
- 七、我国高性能数模混合集成电路设计获突破71
- 八、松下半导体公司开发出世界最小集成电路芯片72

第三节中国高性能集成电路技术建议及策略72

- 一、突破集成电路等核心产业的关键技术73
- 二、技术提升助力发展模式转型73

第七章2013-2016年中国高性能集成电路行业重点企业运营财务数据分析75

第一节同方股份75

- 一、企业概况75
- 二、企业财务情况分析76
- 三、企业主营业务分析78

第二节综艺股份79

一、企业概况	79
二、企业财务情况分析	80
三、企业主营业务分析	83
第三节上海贝岭	84
一、企业概况	84
二、企业财务情况分析	85
三、企业主营业务分析	87
第四节三佳科技	88
一、企业概况	88
二、企业财务情况分析	89
三、企业主营业务分析	92
第五节通富微电	92
一、企业概况	92
二、企业财务情况分析	93
三、企业主营业务分析	96
第六节华天科技	96
一、企业概况	96
二、企业财务情况分析	98
三、企业主营业务分析	100
四、企业未来发展的机遇与挑战	101
第七节长电科技	102
一、企业概况	102
二、企业财务情况分析	103
三、企业主营业务分析	106
第八章高性能集成电路行业市场竞争策略分析	107
第一节行业竞争结构分析	107
一、行业产品竞争结构	107
二、行业企业竞争格局	108
三、行业应用领域竞争格局	108
第二节高性能集成电路的市场竞争策略分析	109
一、高性能集成电路的市场增长潜力分析	109

二、IP核是我国集成电路设计产业发展重中之重109

三、中国芯片企业猛生芯片企业数量和质量齐升110

第三节高性能集成电路的企业竞争策略分析111

第九章高性能集成电路行业投资分析113

第一节2013-2016年高性能集成电路行业投资情况分析113

一、中国未来五年将向集成电路行业投资250亿美元113

二、2013-2016年1-7月集成电路及相关行业固定资产投资情况113

三、高性能集成电路行业重点投资方向120

四、高性能集成电路行业投资新方向120

第二节高性能集成电路的投资项目分析121

一、寸集成电路项目启动投资预算亿元121

二、华天科技拟募资8.34亿投资三大集成电路项目121

三、国产极大规模集成电路平坦化材料量产122

四、国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”2013-2016年项目123

五、河南省企业投资项目备案情况124

第三节2013-2016年高性能集成电路的投资机会分析125

第十章高性能集成电路产业链分析127

第一节高性能集成电路行业产业链概况127

第二节高性能集成电路上下游产业分析127

一、上游产业垄断程度高127

二、下游产业分析128

第三节主要原材料供应及价格分析128

一、高性能集成电路原材料概况128

二、中国多晶硅供求市场分析129

三、日本地震意外拉动多晶硅市场价格上涨129

四、国内高性能集成电路加大产能上下游芯片需求强劲130

第十一章2018-2024年中国高性能集成电路行业发展前景预测分析132

第一节高性能集成电路产业发展10年回顾分析132

- 一、产业规模不断扩大，三业比重渐趋合理132
- 二、技术水平不断提高，知识产权取得突破132
- 三、优势企业不断涌现，产业链互动日趋活跃133
- 四、海内外人才大量汇聚，产业与资本良性互动133
- 五、公共服务成效显著，产业环境日趋完善133
- 第二节高性能集成电路的行业发展前景分析134
 - 一、金融危机下高性能集成电路的市场的市场前景134
 - 二、2013-2016年高性能集成电路的市场面临的发展商机135
 - 三、“十三五”高性能集成电路产业的发展机遇135
- 第三节高性能集成电路未来发展预测分析136
 - 一、中国高性能集成电路的行业发展规模预测136
 - 二、2018-2024年中国高性能集成电路的行业发展趋势预测137

第十二章2018-2024年高性能集成电路行业投资风险分析139 (ZY LII)

- 第一节当前高性能集成电路的存在的问题139
- 第二节2018-2024年中国高性能集成电路的行业投资风险分析139
 - 一、市场竞争风险139
 - 二、原材料压力风险分析140
 - 三、技术风险分析140
 - 四、政策和体制风险141
 - 五、投融资风险141
 - 六、外资进入现状及对未来市场的威胁142
 - 七、进入退出风险142
 - 八、信贷建议143
- 第三节专家建议143 (ZY LII)

图表目录：

- 图表1：2013-2016年7月份及全年主要统计数据5
- 图表2：中国高性能集成电路行业主要政策措施一览表17
- 图表3：2013-2016年中国集成电路市场销售额规模及增长率39
- 图表4：新老十八号文主要政策对比表50
- 图表5：全球运用纳米技术的集成电路市场预测57

图表6：集成电路的技术发展趋势图57

图表7：同方股份概况

图表8：2014-2016年同方股份主要财务指标分析67

图表9：2014-2016年同方股份资产与负债表分析67

图表10：2014-2016年同方股份利润构成与盈利能力分析68

图表11：2013-2016年同方股份简要财务指标分析68

图表12：2014-2016年同方股份经营与发展能力分析69

图表13：2013-2016年同方股份主营构成分析69

图表14：综艺股份概况70

图表15：2014-2016年综艺股份主要财务指标分析71

图表16：2014-2016年综艺股份资产与负债表分析72

图表17：2014-2016年综艺股份利润构成与盈利能力分析72

图表18：2012-2016年综艺股份简要财务指标分析72

图表19：2014-2016年综艺股份经营与发展能力分析73

图表20：2013-2016年综艺股份主营构成分析74

图表21：上海贝岭概况74

图表22：2014-2016年上海贝岭主要财务指标分析75

图表23：2014-2016年上海贝岭资产与负债表分析76

图表24：2014-2016年上海贝岭利润构成与盈利能力分析76

图表25：2013-2016年上海贝岭简要财务指标分析77

图表26：2014-2016年上海贝岭经营与发展能力分析77

图表27：2013-2016年上海贝岭主营构成分析78

图表28：三佳科技概况78

图表29：2014-2016年三佳科技主要财务指标分析80

图表30：2014-2016年三佳科技资产与负债表分析80

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/7741286EJP.html>